

# 第35回 レーザ協会セミナー

## 「時代を切り拓く新しいレーザ加工」

レーザ協会は例年秋にセミナーを開催しております。このセミナーも回を重ねて今年で35回目を迎えようとしています。これまでセミナーは当協会単独の会場で開催してきましたが、さらにより大勢の方々にご参加いただきたく、今年からは(株)ICSコンベンションデザインが9月末にパシフィコ横浜で開催するInterOpto2011、LaserTech2011のイベントに合わせて開催することに致しました。このようにすることで、レーザ協会セミナー参加者へ、同時開催される展示会への参加など一層の便宜をはかりたく思います。

会員・非会員を問わず皆様にはこの機会に是非ともご参加いただきますようご案内申し上げます。

日時： **2011年9月30日(金) 9:50~17:00**

場所： パシフィコ横浜アネックスホール

協賛： 日本経済新聞社、日刊工業新聞社、(財)光産業技術振興協会  
(財)先端加工機械技術振興協会、(財)光科学技術研究振興財団

会費： 会員・協賛団体会員…20,000円  
非会員…25,000円 学生…3,000円

※申し込みはHP上からお願いします。

INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION 2011

**InterOpto<sup>®</sup>2011**

**LaserTech2011**

### ■プログラム

| 時間          | 講演内容 / 講演者  |
|-------------|---|
| 9:50~10:00  | 開会挨拶  |
| 10:00~10:45 | <b>加工用光源 — 短波長と短パルスレーザ</b> / 東京理科大学 渡部 俊太郎  |
| 10:45~11:30 | <b>産業用レーザの世界市場動向</b> / Industrial Laser Solutions (Editor in Chief) David A. Belforte |
| 11:30~12:15 | <b>TWIにおける最近のレーザ加工の研究</b> / TWI: 英国溶接研究所 (Director) Graham Wylde                      |
| 12:15~13:30 | 昼休み   |
| 13:30~14:15 | <b>レーザカラーマーキング技術および装置開発</b> / シグマ光機(株) 朝岡 淳一  |
| 14:15~15:00 | <b>半導体基板のステルスダイシング</b> / 浜松ホトニクス(株) 内山 直己   |
| 15:00~15:15 | 休憩  |
| 15:15~16:00 | <b>ファイバーレーザによるマーキング&amp;微細加工</b> / パナソニック電工SUNX(株) 神谷 東志一                             |
| 16:00~16:45 | <b>レーザ切断分野での最新技術動向</b> / 三菱電機(株) 久場 一樹  |

お問い合わせ先

レーザ協会 <http://www.soc.nii.ac.jp/jslt/>

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-8-4 市橋ビル3F (株)PDS内

Tel.03-6277-5271(担当:木村) Fax.03-3261-5722 e-mail:laserkyokai@kkpds.co.jp